



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

 Commissioner for Patents, Box PCT
 United States Patent and Trademark Office
 Washington, D.C. 20231
 www.uspto.gov

U.S. APPLICATION NUMBER NO.	FIRST NAMED APPLICANT	ATTY. DOCKET NO.
09/807,948	Paul Ranft	H 3516 PCT/US

INTERNATIONAL APPLICATION NO.	
PCT/EP99/07683	

I.A. FILING DATE	PRIORITY DATE
10/13/1999	10/22/1998

Henkel Corporation Law Dept.
 2500 Renaissance Boulevard., Suite 200
 Gulph Mills, PA 19406

CONFIRMATION NO. 9265

371 FORMALITIES LETTER



OC000000007697950

Date Mailed: 03/22/2002

NOTIFICATION OF DEFECTIVE RESPONSE

The following items have been submitted by the applicant or the IB to the United States Patent and Trademark Office as an Elected Office (37 CFR 1.495):

- U.S. Basic National Fee
- Priority Document
- Copy of IPE Report
- Copy of references cited in ISR
- Copy of the International Application
- Copy of the International Search Report
- Information Disclosure Statements
- Oath or Declaration
- Preliminary Amendments

The following items **MUST** be furnished within the period set forth below in order to complete the requirements for acceptance under 35 U.S.C. 371:

- Oath or declaration of the inventors, in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b), identifying the application by the International application number and international filing date. The current oath or declaration does not comply with 37 CFR 1.497(a) and (b) in that it:
 - The second inventor's name on the published application, Wustrich Liane, is different on the submitted declaration, Liane Meuten.

Applicant is required to complete the response within a time limit of ONE MONTH from the date of this Notification or within the time remaining in the response set forth in the Notification of Missing Requirements, whichever is the longer. No extension of this time limit may be granted under 37 CFR 1.136, but the period for response set in the Notification of Missing Requirements may be extended under 37 CFR 1.136(a).

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

*A copy of this notice **MUST** be returned with the response.*

WINSTON M ALVARADO

Telephone: (703) 305-6421

PART 2 - OFFICE COPY

U.S. APPLICATION NUMBER NO.	INTERNATIONAL APPLICATION NO.	ATTY. DOCKET NO.
09/807,948	PCT/EP99/07683	H 3516 PCT/US

FORM PCT/DO/EO/916 (371 Formalities Notice)

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : G06K 19/077, B29C 45/14, C09J 5/06		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/25264
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 4. Mai 2000 (04.05.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/07683		(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Oktober 1999 (13.10.99)			
(30) Prioritätsdaten: 198 48 712.6 22. Oktober 1998 (22.10.98) DE		Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.	
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WÜSTRICH, Liane [DE/DE]; Krischer Strasse 79, D-40789 Monheim (DE). RANFT, Paul [DE/DE]; Lodenheide 34, D-40724 Hilden (DE). GRÜTZNER, Jürgen [DE/DE]; Bitburger Strasse 35 a, D-47259 Duisburg (DE). KOLB, Uwe [DE/DE]; Vogtlandstrasse 16, D-71111 Waldenbuch (DE).			
(54) Title: HOT-MELT ADHESIVE COMPONENT LAYERS FOR SMART CARDS			
(54) Bezeichnung: KOMPONENTENSCHICHT FÜR SMART CARDS AUS SCHMELZKLEBSTOFFEN			
(57) Abstract			
The invention relates to the utilization of thermoplastic hot melt adhesives for the production of component layers in smart cards or for the production of electronic transponders with the aid of a low pressure injection molding process at pressures ranging between 1 and 50 bar. Preferably, hot melt adhesives based on polyamide, polyurethane, polyester, atactic polypropylene, EVA copolymers or low molecular weight ethylene copolymers or the mixtures thereof are used in said method.			
(57) Zusammenfassung			
Es wird die Verwendung von thermoplastischen Schmelzklebstoffen zur Herstellung von Komponentenschichten in Smart Cards oder zur Herstellung von elektronischen Transpondern mit Hilfe eines Niederdruck-Spritzgußverfahrens bei Drücken zwischen 1 und 50 bar beschrieben. Vorzugsweise finden für dieses Verfahren Schmelzklebstoffe auf der Basis von Polyamid, Polyurethan, Polyester, ataktischem Polypropylen, EVA-Copolymeren oder niedermolekularen Ethylen-Copolymeren oder deren Mischungen Verwendung.			
<p><i>Defective Declaration incorrect name on deck.</i></p>			